

2007年5月11日

2007年3月期 決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2007年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2006年3月期		2007年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	88,290	100.0	99,743	100.0	13.0
売上総利益	11,516	13.0	14,106	14.1	22.5
営業利益	3,100	3.5	3,531	3.5	13.9
経常利益	2,630	3.0	3,245	3.3	23.4
当期純利益	1,537	1.7	1,876	1.9	22.1
1株当たり当期純利益	16,525.92円		18,957.04円		
R O E	10.5%		10.7%		
1株当たり年間配当金	6,000円		6,000円		
期末従業員数	564人		739人		

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2007年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2006年3月期	2007年3月期	増減額
現預金	798	1,142	344
受取手形・売掛金	17,017	23,361	6,344
たな卸資産	15,816	16,888	1,071
その他流動資産	1,116	1,994	878
有形固定資産	723	1,019	296
無形固定資産	169	227	57
投資その他の資産	1,446	2,094	648
資産計	37,088	46,729	9,640

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2007年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2006年3月期	2007年3月期	増減額
買掛金	12,253	12,888	634
短期借入金	1,698	4,351	2,653
その他流動負債	2,020	5,478	3,457
長期借入金	3,000	-	3,000
その他固定負債	2,955	3,954	999
負債計	21,928	26,673	4,744
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	2,054	5,645	3,590
利益剰余金	10,605	11,913	1,307
評価・換算差額等	4	1	2
純資産計	15,160	20,056	4,895
負債・純資産計	37,088	46,729	9,640

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2007年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

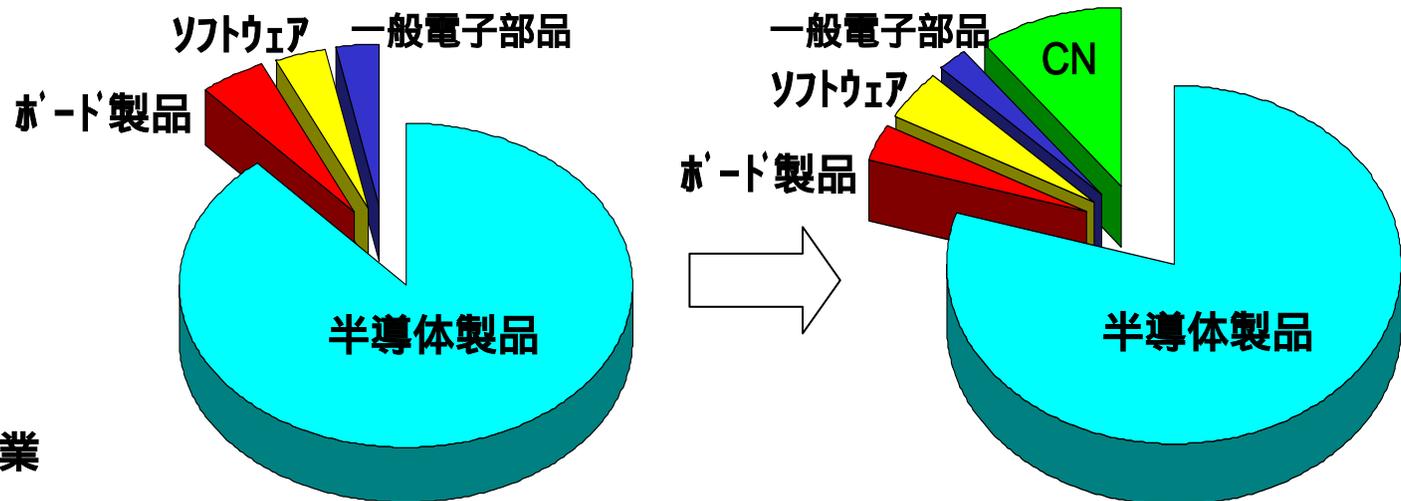
	2006年3月期	2007年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	3,930	1,654	2,275
投資キャッシュ・フロー	200	401	200
財務キャッシュ・フロー	3,867	902	2,965
現金等の増減額	128	344	472

* 2006年10月に東京エレクトロン(株)からコンピュータ・ネットワーク事業を承継いたしました。

2007年3月期 連結品目別売上高

(単位:百万円)

	品目	2006年3月期		2007年3月期		増減率 (%)
		売上高	構成比%	売上高	構成比%	
EC	半導体製品	78,235	88.6	79,569	79.8	1.7
	ボード製品	4,171	4.7	3,264	3.3	21.7
	ソフトウェア	3,148	3.6	4,527	4.5	43.8
	一般電子部品	2,734	3.1	2,108	2.1	22.9
CN	コンピュータ・ネットワーク	-	-	10,272	10.3	-
	合計	88,290	100.0	99,743	100.0	13.0

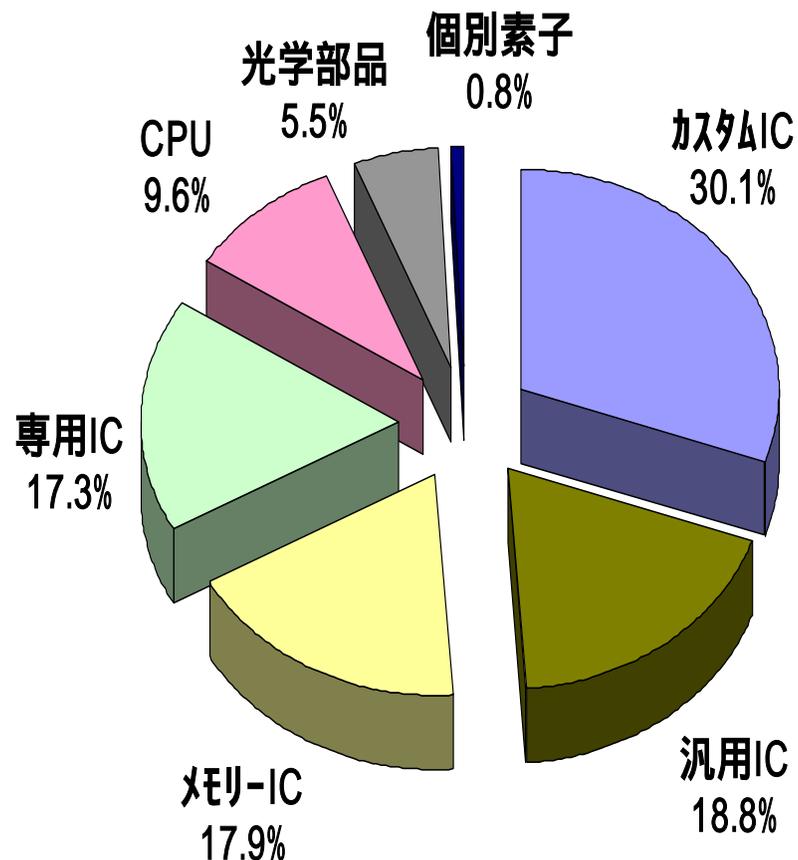


* EC: 電子部品事業

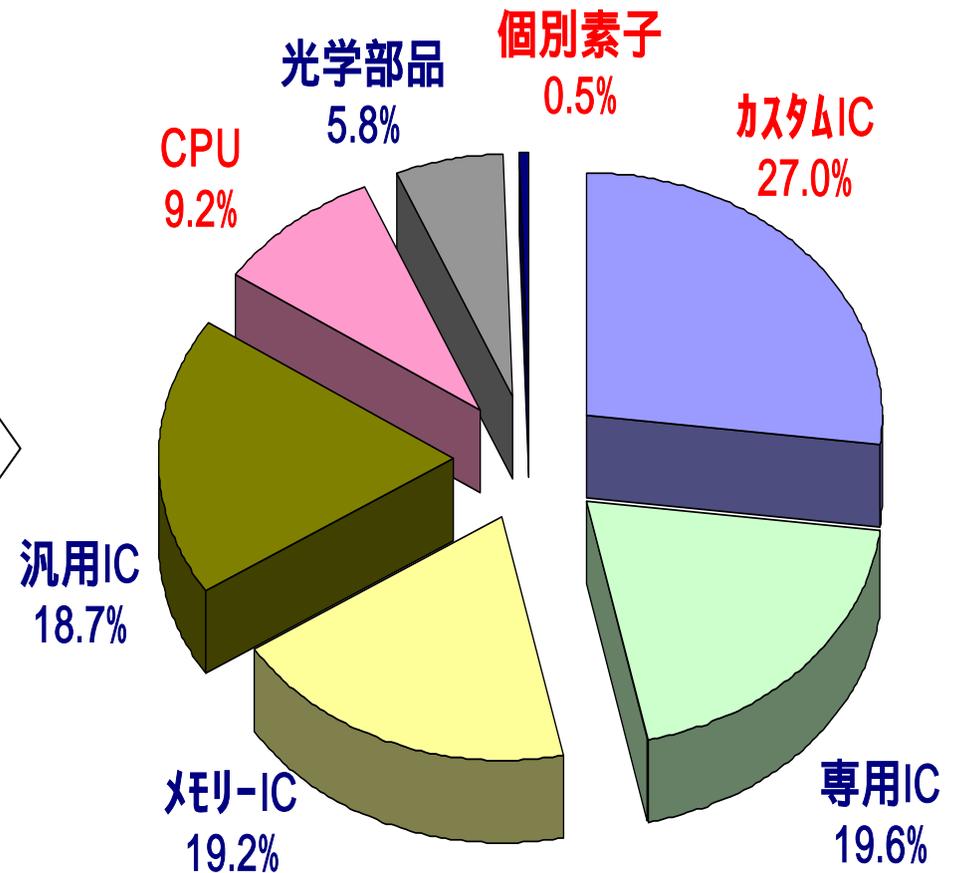
* CN: コンピュータ・ネットワーク事業

2007年3月期 半導体製品売上構成比

< 2006年3月期 >



< 2007年3月期 >

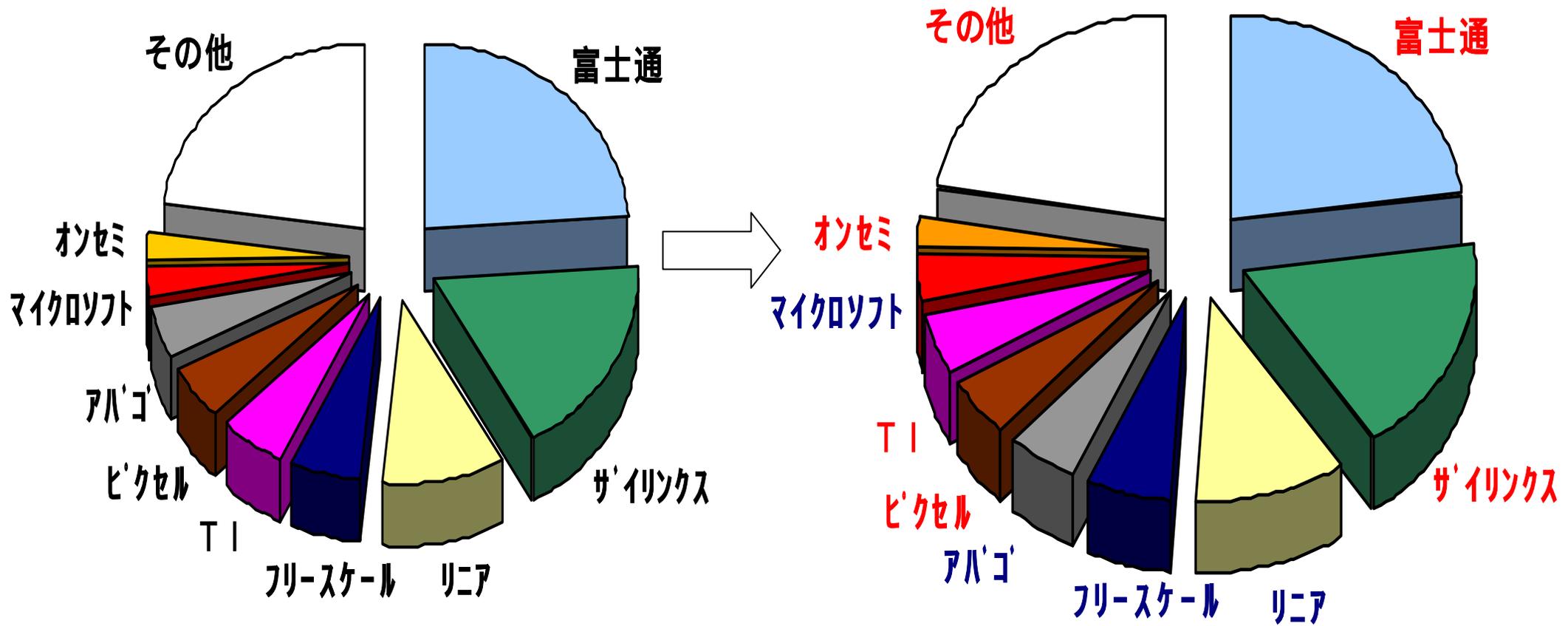


* 品目についての説明は、P.29 ~ P.31をご参照ください。

2007年3月期 商品別売上構成比

< 2006年3月期 >

< 2007年3月期 >



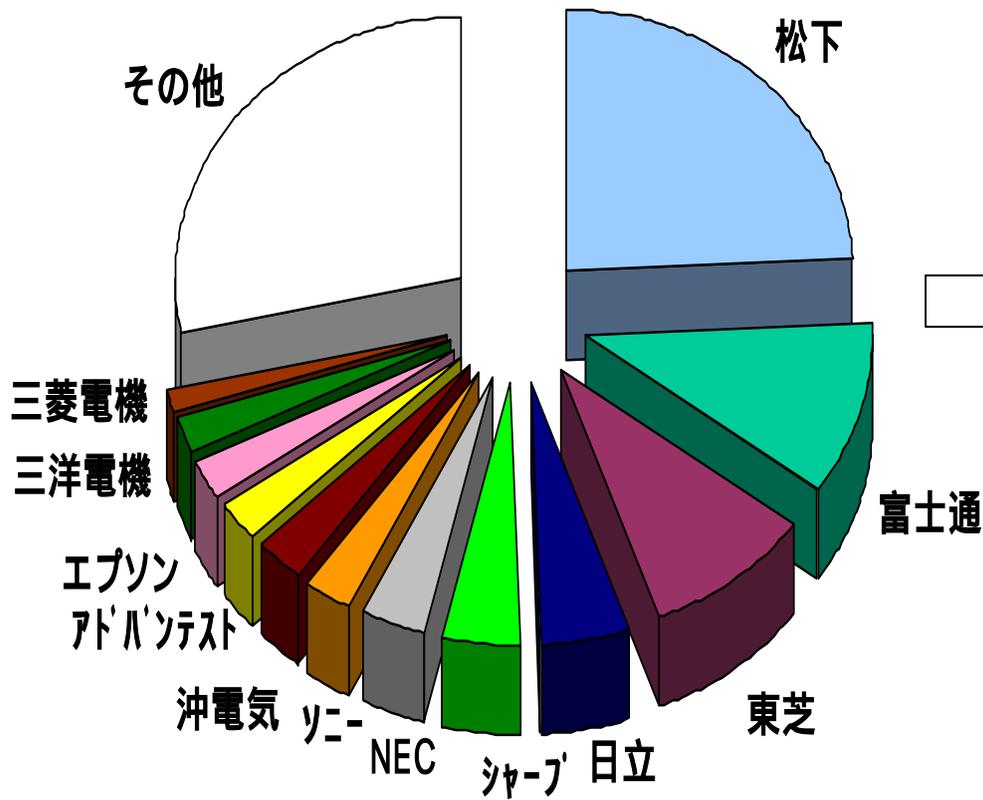
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2007年3月期 主要商品別売上増減要因

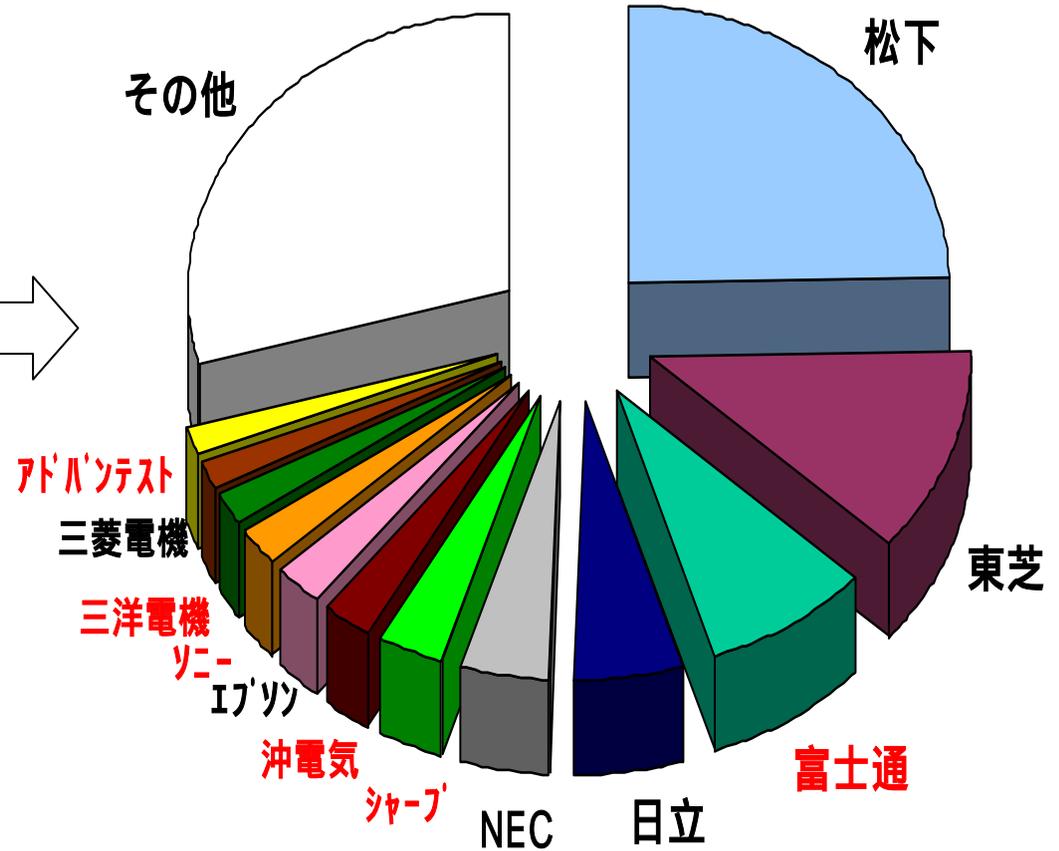
仕入先名	増減率	要 因
富士通(株)	2%	民生機器向け減少
ザイリンクス社	1%	通信機器向け減少も産業機器向け伸長
リニアテクノロジー社	10%	全ての分野で伸長
フリースケール・セミコンダクタ社	6%	携帯電話基地局向け伸長
アバゴ・テクノロジー社	16%	携帯電話向け伸長
ピクセルワークス社	1%	LCDプロジェクタ向け販売数量増加も単価下落を補えず減少
T I 社	12%	半導体試験装置向け減少
マイクロソフト社	49%	POS端末向け大幅伸長
開発ビジネス	3%	設計受託伸長

2007年3月期 顧客別売上構成比

< 2006年3月期 >



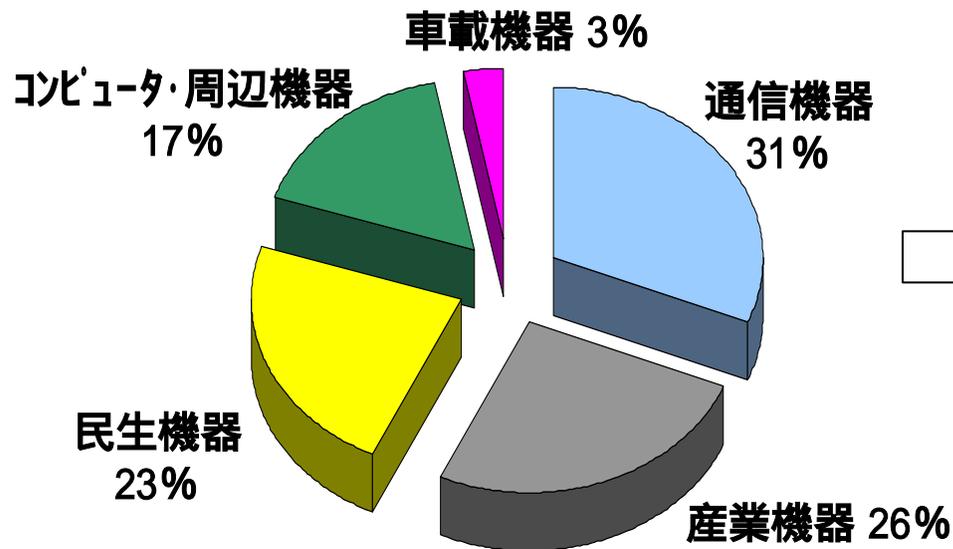
< 2007年3月期 >



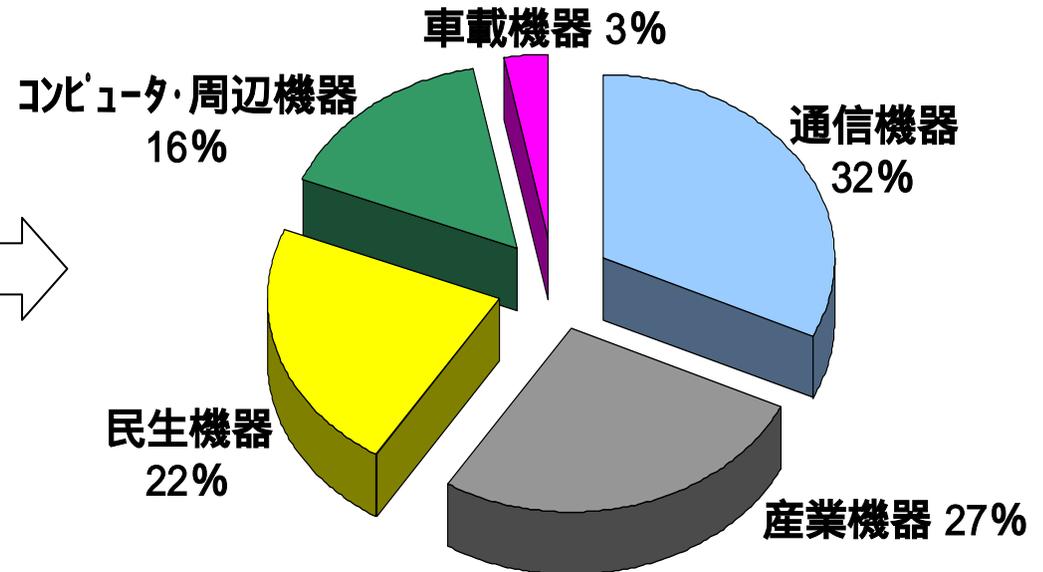
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2007年3月期 用途別売上構成比

< 2006年3月期 >



< 2007年3月期 >



用途	主なアプリケーション
通信機器	ターミナルアダプタ、ケーブルモデム、携帯電話、ルーター、交換機、基地局
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、チューナー、液晶TV、プラズマTV、DVD
コンピュータ・周辺機器	プリンター、液晶プロジェクタ、POS、PC、ワークステーション
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

海外ビジネスについて

東京エレクトロン デバイス香港

	2006年3月期 実績	2007年3月期 実績	2008年3月期 計画
売上高	28億円	64億円	75億円

- ・ 営業開始日 : 2005年4月
- ・ 拠 点 : 香港、上海、大連、
シンガポール(2007年1月開設)

コンピュータ・ネットワーク(CN)事業

事業分野	主な用途・機能	主要仕入先	07/3期 実績	計画比 増減率
ネットワーク 機器	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器など	Extreme F5Networks	39億円	18%
ストレージ 機器	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など	Brocade Emulex	50億円	25%
ミドルウェア	データベース、ログ解析など	Oracle Sensage	13億円	8%



F5Networks

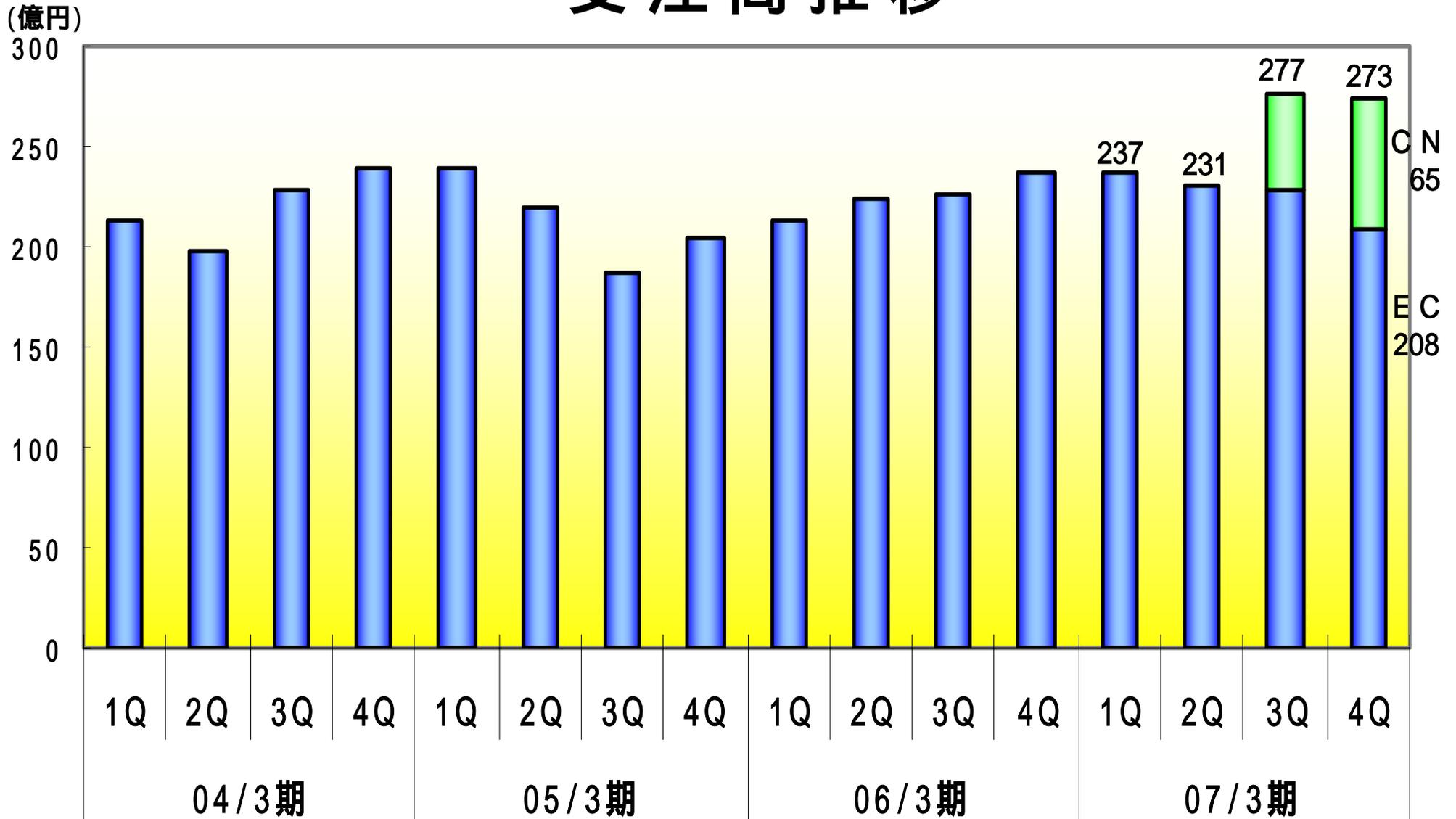


Brocade

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

今期の業績予想について

受注高推移



注) 06/3期より連結決算を開始しており、06/3期1Q以降は、連結受注高を記載しております。

07/3期3QのCN受注高は、事業承継時(10月)の受注残高41億円を含めておりません。

2008年3月期 品目別 連結売上見込み

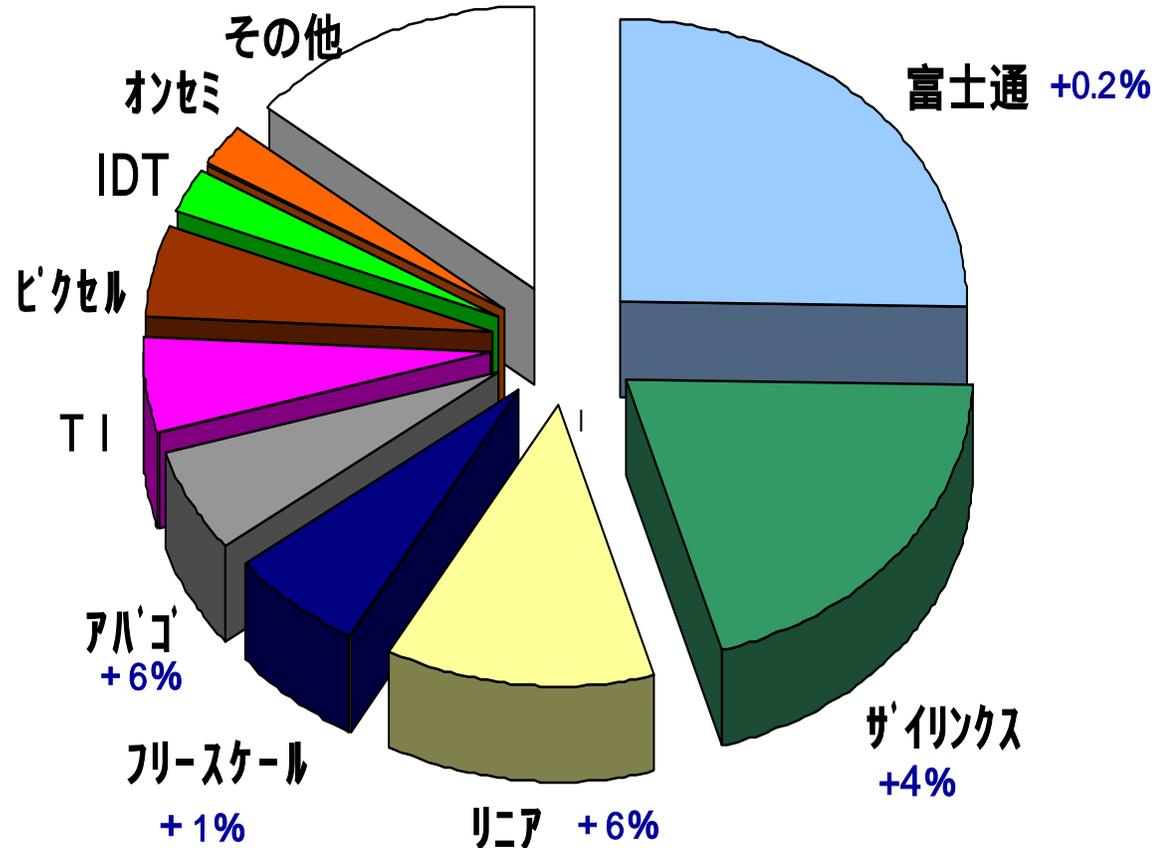
(単位:百万円)

品 目	2007年3月期実績		2008年3期見込み		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体製品	79,569	79.8	81,300	73.9	2.2
コンピュータ・ネットワーク機器	8,918	8.9	15,600	14.2	74.9
ミドルウェア・ソフトウェア*1	5,881	5.9	7,800	7.1	32.6
その他電子部品*2	5,372	5.4	5,300	4.8	1.3
合 計	99,743	100.0	110,000	100.0	10.3

*1 従来のソフトウェアとCN事業ミドルウェアを合算

*2 従来のボード製品と一般電子部品を合算

2008年3月期 半導体製品 売上構成見込み



注) 上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。
 数字は、前年比増減見込みを記載しております。
 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2008年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率(%)
売上高	51,200	58,800	110,000	10.3
営業利益	1,620	2,460	4,080	15.5
経常利益	1,500	2,300	3,800	17.1
当期純利益	870	1,330	2,200	17.2
1株当たり配当金	3,300円	3,300円	6,600円	10.0

今期の活動方針

1. コンピュータ・ネットワーク(CN)事業

サイト構築インテグレーションビジネスの推進

2. 電子部品(EC)事業

- 産業機器分野への販売強化
- 海外事業展開の推進

3. 情報システムの再構築

中期目標

< 2011年3月期 >

売上高

1,500億円

經常利益

75億円

売上高經常利益率

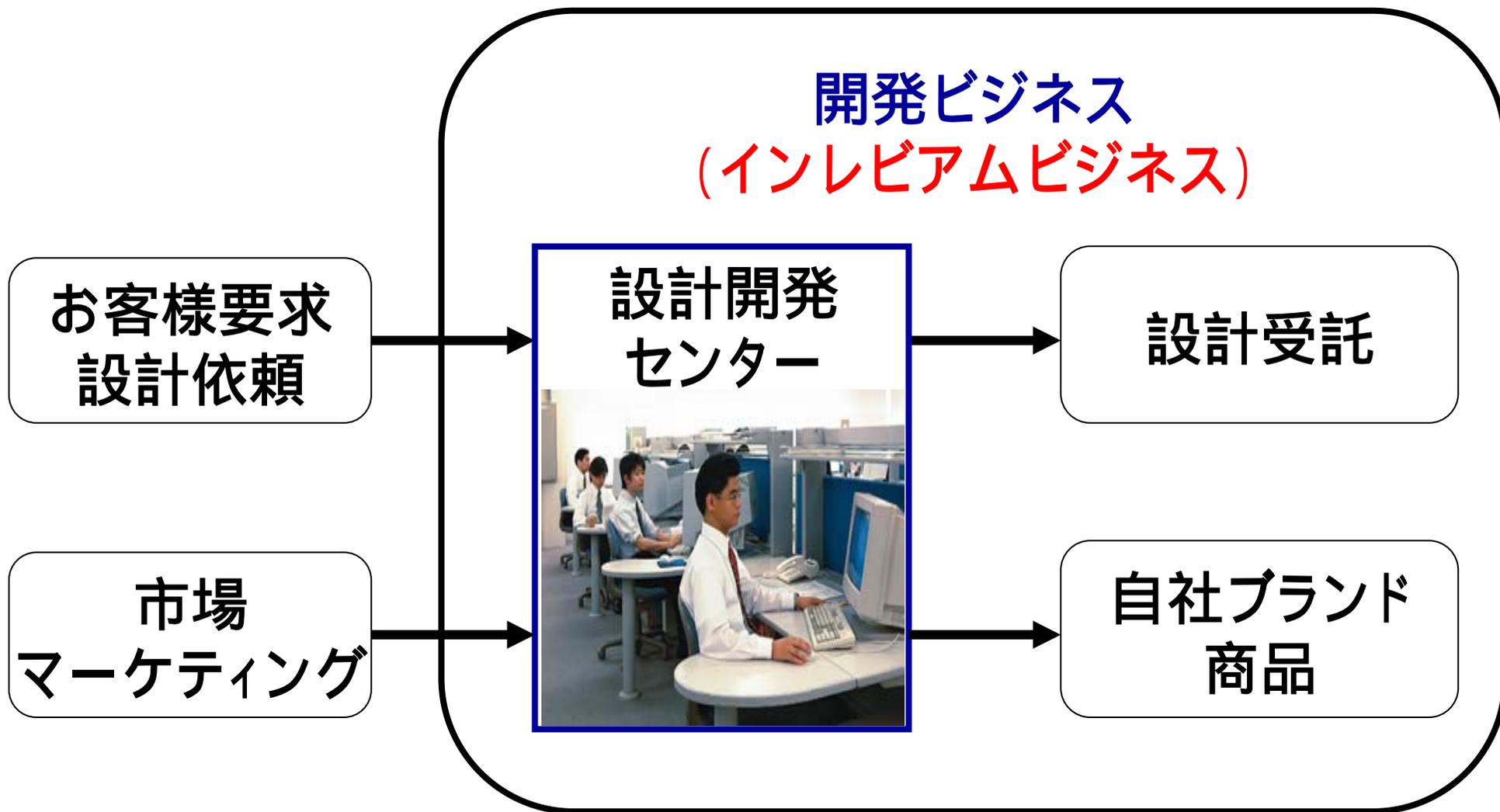
5%以上

開発ビジネスについて

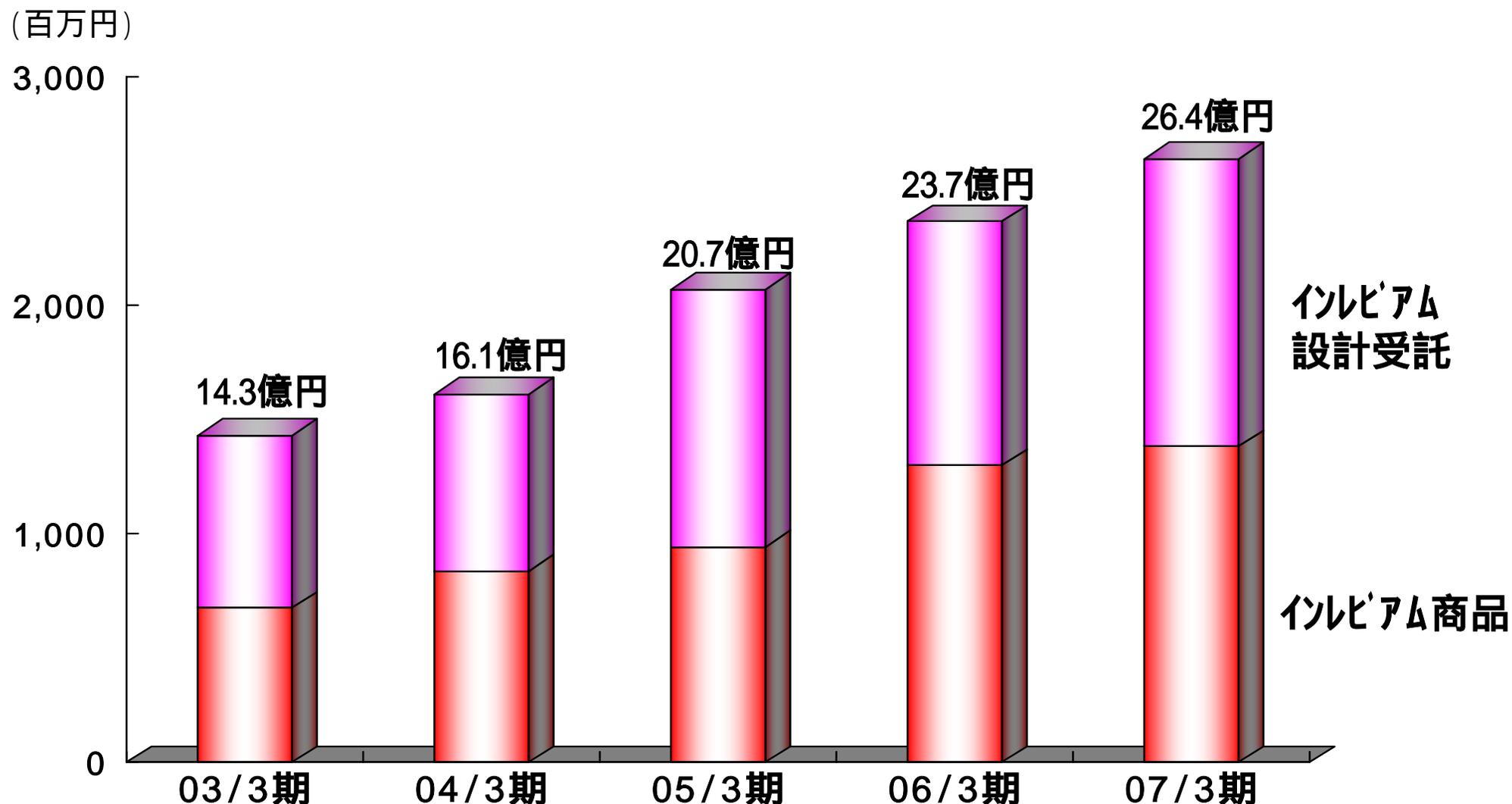
inrevium

(インレビウム)

高付加価値事業への取組み



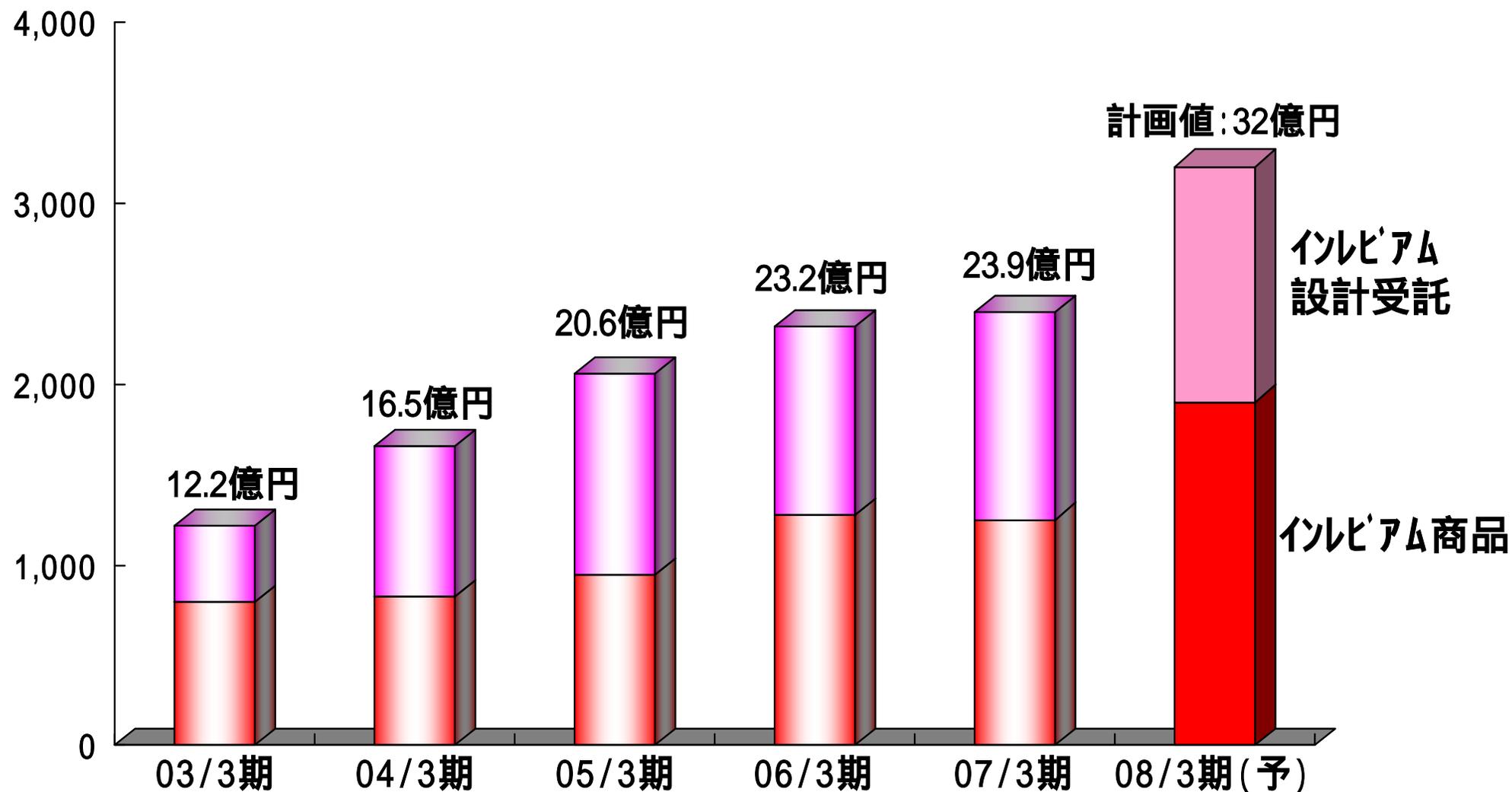
インレビウム受注高推移



注)06/3期より連結決算を開始しており、06/3期以降は、連結受注高を記載しております。

インレビウム売上高推移

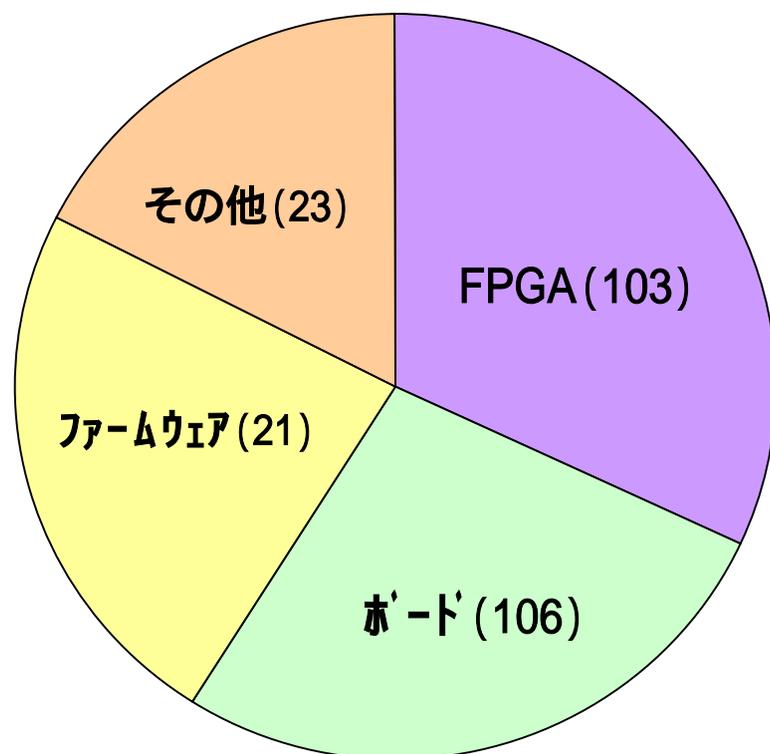
(百万円)



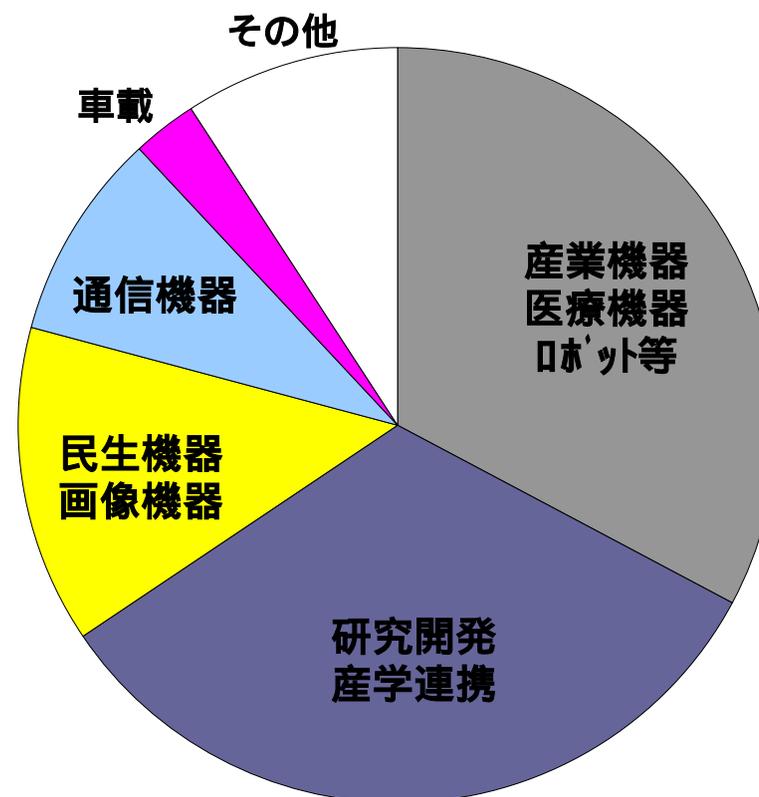
注)06/3期より連結決算を開始しており、06/3期以降は、連結売上高を記載しております。

インレビウム設計受託 実績

< 設計受託開発件数 >
2007年3月期: 253件



< 用途別構成比 >

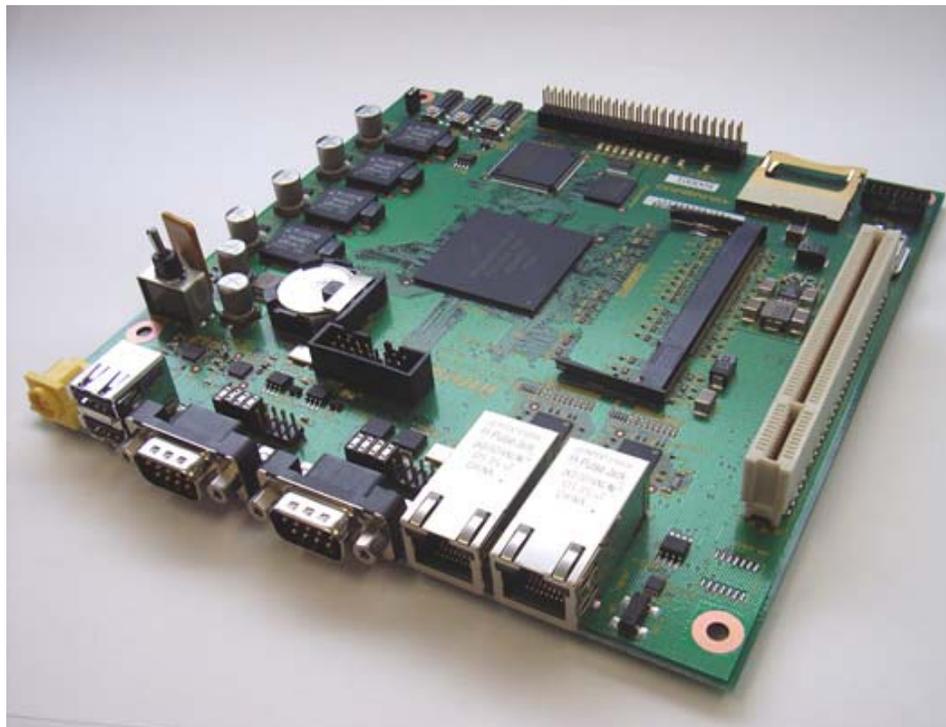


* ファームウェア: 機器の中に組み込まれるソフトウェア

インレビウム商品 開発例

マイクロプロセッサ 評価ボード

- ・当社取扱い商品フリースケール・セミコンダクタ社製
マイクロプロセッサPowerQUICC Proを搭載した評価ボード

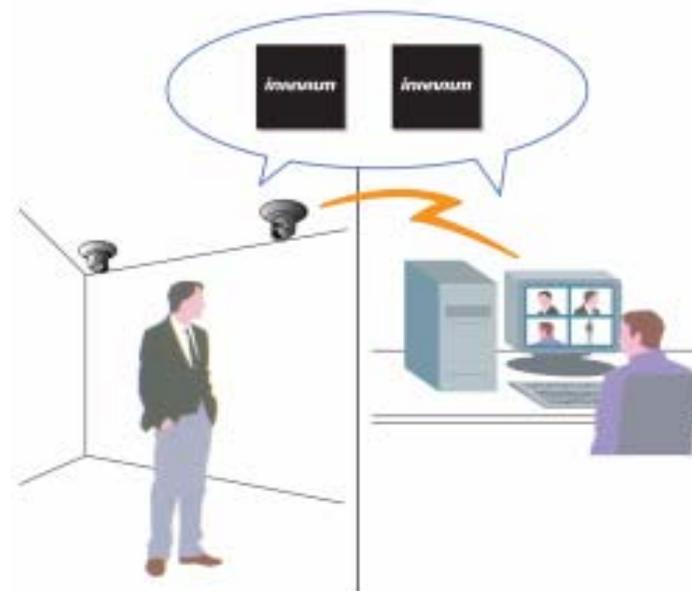


産業機器の開発用

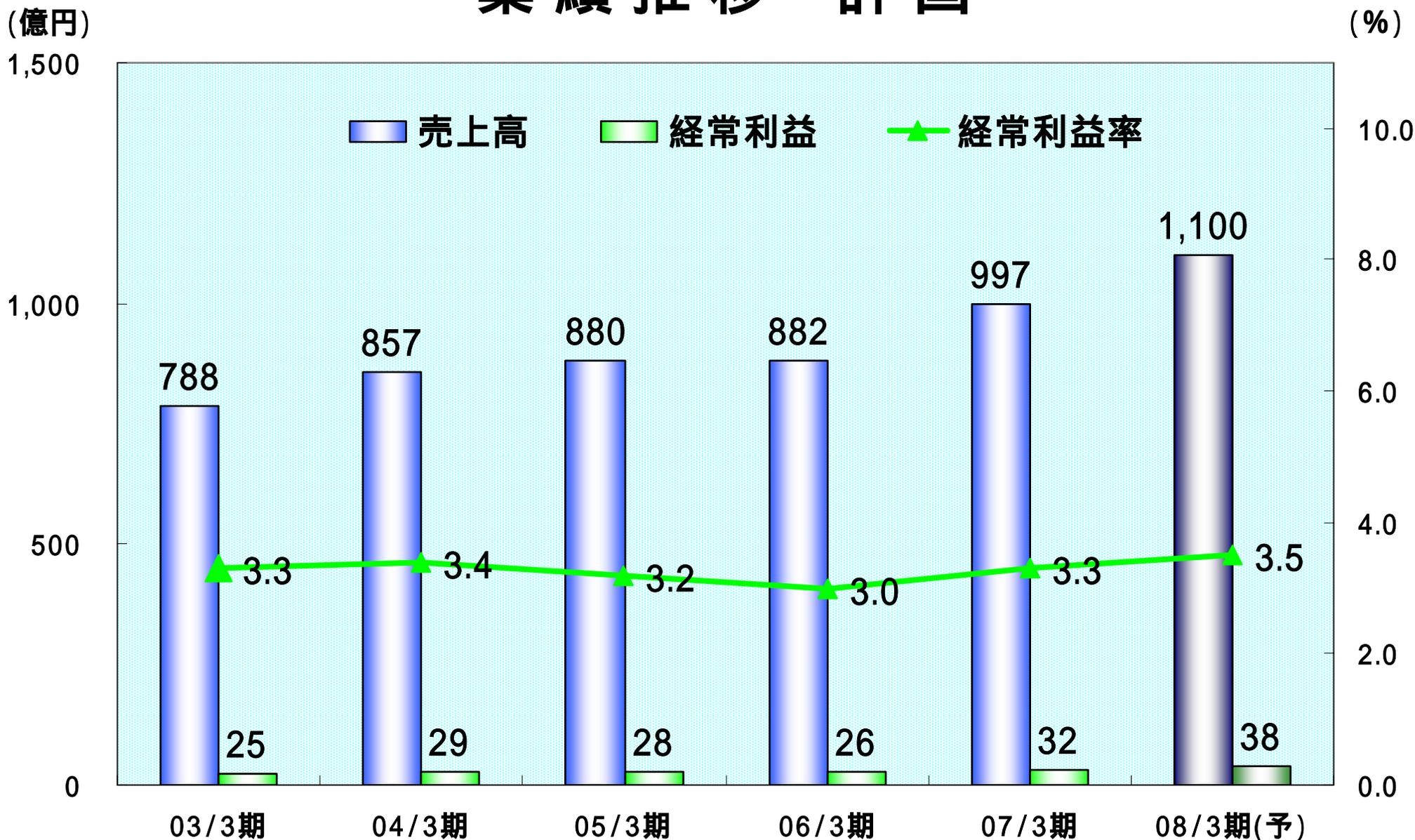
インレビウム商品 開発例

映像機器用LSI

- ・当社保有技術の高速JPEG圧縮/伸長商品を拡充
- ・ターゲットアプリケーション
監視カメラ、ドライブレコーダーなどの映像機器



業績推移・計画



品目別仕入先名

	品目	主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通(株)、ザ・リンクス社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビームなど
	メモリIC	富士通(株)、IDT社、ラムトンインターナショナル社
	汎用IC	リアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通(株)、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
ボード製品		ダイロジック社、インビーム
ソフトウェア		マイクロソフト社、インビーム
一般電子部品		コーセル(株)、(株)デジタル
コンピュータ・ネットワーク		Extreme、F5Networks、Brocade、Emulex、Sensage

用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(サイリックス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカメラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

ボード製品		プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品
ソフトウェア		産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のOSを中心に販売(PC用以外)
一般電子部品		機器間を接続するコネクタやケーブル、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品
コンピュータ・ネットワーク		ネットワーク機器、ストレージ機器、ミドルウェア

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。